

证券代码：688432

证券简称：有研硅

公告编号：2023-004

有研半导体硅材料股份公司

关于使用部分募集资金向控股子公司增资 以实施募投项目的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

有研半导体硅材料股份公司（以下简称“公司”、“有研硅”）于 2023 年 1 月 20 日召开了第一届董事会第十一次会议、第一届监事会第八次会议，审议通过《关于使用部分募集资金向控股子公司山东有研半导体材料有限公司增资用于实施募投项目的议案》，同意公司使用募集资金人民币 74,217.19 万元向控股子公司山东有研半导体材料有限公司（以下简称“山东有研半导体”）进行增资。其中 50,328.1126 万元计入注册资本，其余 23,889.0774 万元计入资本公积金，增资完成后，公司将持有山东有研半导体 85.02%的股权。

公司独立董事、监事会发表了明确的同意意见，保荐机构中信证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）对公司向控股子公司增资以实施募投项目出具了明确的核查意见。

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意有研半导体硅材料股份公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]2047号），同意公司首次向社会公众公开发行人民币普通股（A股）18,714.3158万股，每股发行价格为9.91元，募集资金总额为人民币185,458.87万元，扣除不含税发行费用，实际募集资金净额为人民币166,396.72万元。毕马威华振会计师事

务所（特殊普通合伙）对公司本次公开发行新股的资金到位情况进行了审验，并于 2022 年 11 月 7 日出具《验资报告》（毕马威华振验字第 2201588 号）。

为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司开立了募集资金专项账户。募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准开立的募集资金专项账户内。公司与山东有研半导体、保荐机构、募集资金专户开立银行签署了《募集资金专户存储三方/四方监管协议》。具体情况详见 2022 年 11 月 9 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《有研半导体硅材料股份公司首次公开发行股票科创板上市公告书》。

二、募集资金投资项目情况

根据公司披露的《有研半导体硅材料股份公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》，本次首次公开发行股票募集资金投资项目情况如下：

单位：万元

序号	项目名称	实施主体	项目投资金额	拟投入募集资金金额
1	集成电路用8英寸硅片扩产项目	山东有研半导体	38,482.43	38,482.43
2	集成电路刻蚀设备用硅材料项目	山东有研半导体	35,734.76	35,734.76
3	补充研发与营运资金	有研硅	25,782.81	25,782.81
合计			100,000.00	100,000.00

三、本次增资对象的基本情况

公司名称	山东有研半导体材料有限公司		法定代表人	张果虎
成立日期	2018年8月23日		注册资本	15亿元
注册地址	山东省德州市经济技术开发区袁桥镇东方红东路6596号（中元科技创新创业园）A座921室			
主营业务	半导体材料的研发、生产、销售			
最近一个会计年度的主要财务数据（2021年）	总资产	229,829.96万元	净资产	170,172.14万元
	营业收入	78,874.85万元	净利润	18,296.46万元

以上财务数据已经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

四、公司使用募集资金对控股子公司增资情况

集成电路用 8 英寸硅片扩产项目、集成电路刻蚀设备用硅材料项目的实施主体为公司控股子公司山东有研半导体。公司拟将募集资金人民币 74,217.19 万元向控股子公司山东有研半导体进行增资，其中 50,328.1126 万元计入注册资本，其余 23,889.0774 万元计入资本公积金。山东有研半导体股东德州经济技术开发区景泰投资有限公司（以下简称“德州景泰”）放弃增资。

本次增资后，山东有研半导体股权结构变化如下：

单位：万元

股东名称	增资前出资	出资比例	本次增加注册资本	增资后出资	出资比例
有研硅	120,000.00	80%	50,328.11	170,328.11	85.02%
德州景泰	30,000.00	20%	0	30,000.00	14.98%
合计	150,000.00	100%	50,328.11	200,328.11	100%

山东有研半导体将根据募投项目的实施进度，分阶段投入募集资金，并对募投项目实施单独建账核算，以提高募集资金的使用效率。

五、本次增资目的及对公司的影响

本次使用部分募集资金对山东有研半导体进行增资，是基于公司募集资金使用计划实施的具体需要，有助于推进募投项目的实施，为公司和股东获取更多的投资回报，符合募集资金的使用计划。募集资金的使用方式、用途符合相关法律法规的规定，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司和股东利益的情形。公司对控股子公司山东有研半导体具有经营管理的控制权，财务风险可控。

六、本次使用部分募集资金向控股子公司增资的内部决策程序情况

2023 年 1 月 20 日，公司第一届董事会第十一次会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权以及第一届监事会第八次会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于使用部分募集资金向控股子公司山东有研半导体材

料有限公司增资用于实施募投项目的议案》，同意使用募集资金人民币 74,217.19 万元向控股子公司山东有研半导体进行增资。

公司独立董事、监事会发表了明确的同意意见，保荐机构对本事项出具了明确的核查意见。

七、专项意见说明

(一) 独立董事意见

公司独立董事认为：公司本次使用募集资金对山东有研半导体进行增资，是基于公司募集资金使用计划实施的需要，有助于推进募投项目的实施，为公司和股东获取更多的投资回报，符合募集资金的使用计划，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《有研半导体硅材料股份公司募集资金管理制度》等有关规定的要求，不存在变相改变募集资金用途、损害公司和股东特别是中小股东利益的情形。

因此，全体独立董事同意公司使用募集资金 74,217.19 万元对山东有研半导体进行增资，并最终用于山东有研半导体募投项目的实施。

(二) 监事会意见

监事会认为：公司本次使用募集资金对山东有研半导体进行增资，是基于公司募集资金使用计划实施的需要，有助于推进募投项目的实施，为公司和股东获取更多的投资回报，符合募集资金的使用计划，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《有研半导体硅材料股份公司募集资金管理制度》等有关规定的要求，不存在变相改变募集资金用途、损害公司和股东特别是中小股东利益的情形。

因此，监事会同意公司使用募集资金 74,217.19 万元对山东有研半导体进行增资，并最终用于山东有研半导体募投项目的实施。

（三）保荐机构核查意见

经核查，本保荐机构认为：公司使用募集资金向子公司增资以实施募投项目事项已经董事会、监事会审议通过，独立董事发表了明确同意意见，公司履行了必要的内部审批程序，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规的要求。有关事项不存在与募集资金投资项目的实施计划相抵触的情形，不影响募集资金投资项目建设的正常进行，不存在变相改变募集资金投向且损害股东利益的情形。保荐机构同意公司使用募集资金对子公司增资以实施募投项目。

特此公告。

有研半导体硅材料股份公司董事会

2023年1月31日